

国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
终止部分募集资金投资项目的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司终止部分募集资金投资项目的情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、终止部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095号）核准，公司2021年11月向特定投资者发行人民币普通股（A股）86,095,566股，发行价为23.23元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,998.18元，扣除发行费用（包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、印花税、发行登记费用等）人民币14,656,693.93元，余额为人民币1,985,343,304.25元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月4日出具天职业字[2021]42581号验资报告。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》的规定，本次募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理，公司及子公司南通胜宏科技有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）本次终止部分募集资金投资项目情况

截至 2023 年 1 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额
1	高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目	298,946.52	148,534.33	1,976.40
2	补充流动资金和偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合计		348,946.52	198,534.33	51,976.40

注 1：上表序号 1 项目的已使用募集资金金额数据未经审计。

注 2：公司于 2021 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目募集资金拟投入金额的议案》，针对实际募集资金净额小于计划投入募集资金金额的情况进行调整，将高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目的拟使用募集资金金额由 150,000.00 万元调整为 148,534.33 万元。

本次拟终止部分募集资金投资项目为高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目，拟终止项目涉及的募集资金金额为 148,534.33 万元，占向特定对象发行募集资金净额的比例为 74.82%。

上述项目终止后，公司将科学、审慎地选择新的投资项目，以顺应行业发展趋势及公司发展战略，保障业绩稳健增长。在暂未确定具体项目前，拟终止项目的剩余募集资金将继续存放于募集资金专户中，并在履行必要决策和审批程序后使用。

二、终止部分募集资金投资项目的情况及原因

（一）拟终止募投项目情况

本次拟终止的募投项目为“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，实施主体为公司全资子公司南通胜宏科技有限公司。该项目拟投资总额为 298,946.52 万元，拟使用募集资金 148,534.33 万元，原计划建设期为 24 个月，第三年开始达产 50%，第四年开始满产。

截至 2023 年 1 月 31 日，该项目实际投入募集资金 1,976.40 万元，投资进度 1.33%，尚未达到预定可使用状态。

（二）终止原募投项目的原因

“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”系公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的募投项目，原计划扩充现有产品产能，同时对公司产品结构进行升级。但由于宏观经济增速、疫情、国际环境等多方面影响，公司所处 PCB 行业的短期需求暂时放缓。Prismark

报告指出，2022 年全球电子整机市场需求进一步下降，PC、手机和电视市场，以及汽车行业需求持续疲软，预测 2022 年全球 PCB 增长率为 2.9%，且 2023 年将下降 2%；相较于公司筹划募投项目之时 2021 年度全球 PCB 市场规模 14% 的预测增速，PCB 行业短期增速明显放缓。

在短期增速放缓的背景下，PCB 行业长期发展前景仍然良好。同时，随着电子产业链在东南亚地区的发展，公司诸多下游客户及同行业企业在东南亚投资建厂，以获取产业集聚、低要素成本等竞争优势。顺应该发展趋势以及客户需求，公司亦规划在越南、泰国等东南亚地区投资，将在认真考察和详细论证后，确定新的募集资金投资项目，并在履行必要的审议程序后择机启动。

三、剩余募集资金的使用计划

上述募集资金投资项目终止后，公司将科学、审慎地选择新的投资项目，拟使用剩余募集资金在东南亚地区投资建厂。在暂未确定具体项目前，拟终止项目的剩余募集资金将继续存放于募集资金专户中，并在履行必要决策和审批程序后使用。

四、终止部分募集资金投资项目对公司的影响

本次终止部分募集资金投资项目是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于公司科学合理使用募集资金及保障资金效益。目前公司业务经营情况正常，本次终止部分募投项目对公司现有生产经营活动和长期发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、已履行及尚需履行的审议程序

（一）董事会意见

公司于 2023 年 2 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。本次终止部分募集资金投资项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。上述事项仍需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目的审议程序符合相关法律

法规的规定，是公司根据市场环境变化及经营实际而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于保障资金投入的经济效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次终止部分募集资金投资项目，充分考虑了市场环境变化及公司经营实际，有利于公司科学合理使用募集资金及保障资金效益，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

胜宏科技本次终止部分募投项目事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦针对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。本次终止部分募投项目，是公司根据客观情况作出的审慎决策，有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益，不存在损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。保荐机构对公司本次终止部分募投项目事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

郭振国

王攀

国信证券股份有限公司

年 月 日